

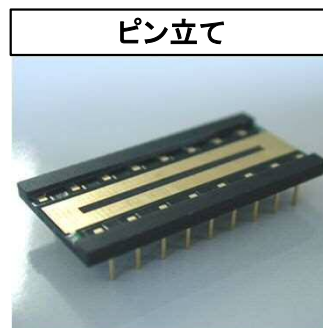
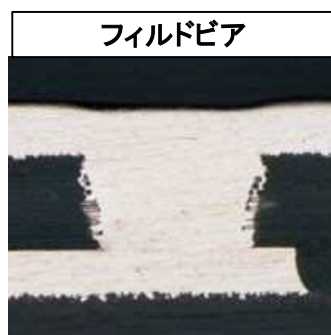
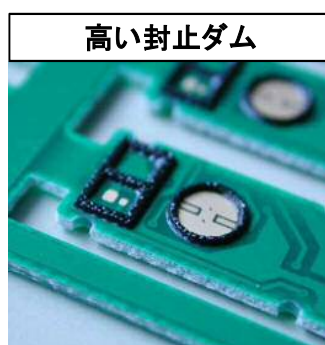
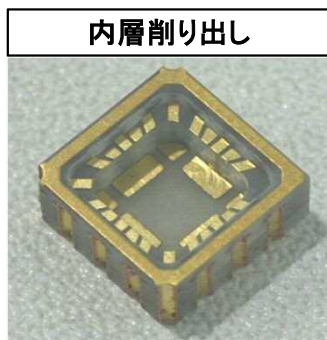
ひとわざ(一技)名: プリント配線基板加工技術

1. 概要(200字目安)

両面・片面・ビルドアップ基板における加工技術

1. 内層削り出し・・・内層銅箔パターンを削り出すことで多段層のキャビティ部を形成する技術
2. 高い封止ダム・・・COB基板等において、封止樹脂の封止ダムを通常より高さのあるダムを形成する技術
3. 貼り合わせ・・・リジット基板と封止枠、リジット基板と金属板(放熱板)などの貼り合わせ技術
4. フィールドビア・・・ビルドアップビア内すべてを銅めっきで埋めてしまう技術
5. ピン立て・・・半田を用いずに、リードピンを基板に固定する技術

写真・図(要点説明)



2. 企業概況

会社名	日本ミクロン株式会社		代表者名	小松 隆次			
			窓口担当	関 浩治			
事業内容	マイクロエレクトロニクスパッケージの製造販売		URL	http://www.nihon-micron.co.jp			
主要製品	FA・産業機器向け基板、医療・精密機器向け基板、LED基板、PKG関連基板 他						
住所	〒394-0048 長野県岡谷市川岸上3-4-5						
電話/FAX	0266-23-8373/0266-23-1223		E-mail	seki@nihon-micron.co.jp			
資本金(百万円)	48	設立年月日	1975年9月	売上(百万円)	1000	従業員数	60

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③医療分野参入(取引)実績 他

- ①ISO9001 : 2000年版取得(2003年8月)
ISO14001 : 2004年版取得(2005年9月)
- ②設計前の構造検討からご相談に応じます
- ③医療分野参入(取引)実績=多数有り